



美國出題 · 台灣解題

台美硬體新創協同解題平台 | 誠邀會員與台灣企業成為解題夥伴

TUVIDA × Atomica (Boston) × Liminal

理事長 | 社團法人中華民國無人載具系統產業發展協會 (TUVIDA)

2026 年 9 月 28 日

結論先講

TUVIDA 攜手 Atomica、Liminal 建立「美國出題・台灣解題」平台：
兩端夥伴盤點新創的真實需求，協會負責找對的台灣企業解題。



真實需求

題目來自波士頓新創在原型、DFM、量產上實際卡關的問題，不是展會名片交換。



協會把關

協會先篩題、評估可行性，再依會員能力推薦，降低雙方媒合成本與風險。



價值升級

從「接單代工」往「早期共同開發」移動，提早卡位下一代客戶與技術。

協會邀請：即日起登錄解題夥伴，並報名 11 月中旬「台美硬體新創合作論壇」，現場促成首批 MOU。

為什麼是現在

三股力量同時成形：供應鏈重組、美國新創量產瓶頸、台灣價值升級



非紅供應鏈需求

- 地緣競爭升高，AI、半導體、低軌衛星、無人機等領域更重視供應鏈可信度
- 台灣是美國新創尋找可信製造夥伴的優先選項



美國新創的量產瓶頸

- 軟體與核心演算法強，但複雜硬體的原型與 DFM 階段常卡關
- 美國本地缺少具量產經驗的專業工程人力



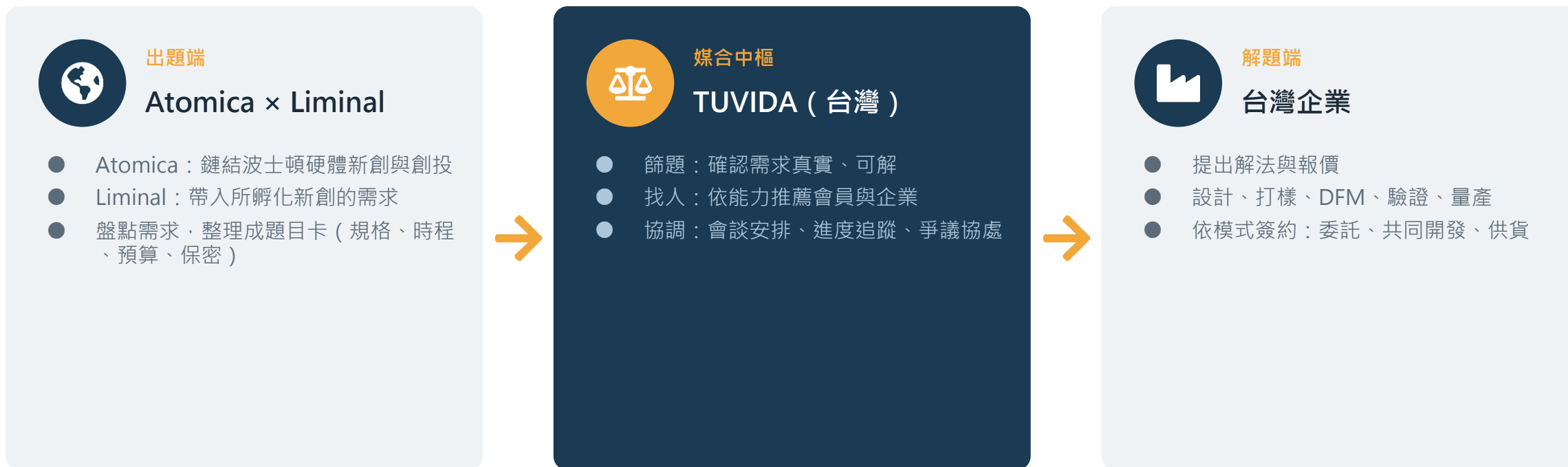
台灣產業價值升級

- 從純代工走向共同開發、共同擁有技術
- 早期參與研發，才有機會分享高附加價值

台灣的機會：成為美國新創從原型走到量產時，最先被想到的可信任夥伴。

平台怎麼運作

波士頓端「出題」，台灣端「解題」，協會居中把關與媒合



支援資源：法人研究機構（如工研院）可視題目協助可行性與實驗室驗證；協會結合法人與學研會員，協助企業申請 A+、產創平台、SBIR、CITD 等經濟部研發補助（詳見第 13 頁）。

分工清楚：Atomica 與 Liminal 管需求端、協會管供給端，企業專注在解題本身。

三方合作夥伴

TUVIDA 與 Atomica、Liminal 共同推動：其中 Liminal 為 Temasek 成立的 Founders' Studio



出題端

Atomica

波士頓硬體新創聚集地 + 加速器

- 舉辦活動、媒體、平台三大引擎
- 連結 FSV 與 10+ 家波士頓創投
- MIT CSAIL、MassRobotics 等生態系
- 平台角色：盤點波士頓新創需求、出題



出題端

Liminal

由新加坡淡馬錫 (Temasek) 成立的 Founders' Studio

- 與創辦人共同打造新創 (venture building)
- 具 Temasek 資本與國際網絡
- 亦為 Atomica 的創投與投資夥伴
- 平台角色：帶入所孵化新創的硬體需求 (分工細節待確認)



解題端樞紐

TUVIDA

社團法人中華民國無人載具系統產業發展協會

- 串連會員與台灣製造、設計、驗證能量
- 篩題、推薦解題夥伴、協調會談
- 主辦 11 月中旬論壇與 MOU 簽署
- 平台角色：找對的台灣企業解題並追蹤落實

三方各司其職：Atomica 與 Liminal 帶來新創需求與國際資本網絡，協會負責台灣端的媒合與落實。

從出題到解題：五個步驟

每一題都走相同流程，企業可在任一步驟決定是否續行

01



出題

Atomica / Liminal 訪談
新創，整理題目卡：問
題、規格、時程、預算

02



篩題

協會審題：技術可行性
、是否涉管制、需求是
否明確

03



媒合

協會向合適的解題夥伴
推薦，簽 NDA 後開放完
整資訊

04



提案

企業提出解法、時程與
報價，與新創線上會談

05



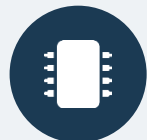
解題

簽約執行：打樣、驗證
、DFM，成功者進入量
產供貨

企業在「提案」前只需投入評估時間；是否簽約由企業與新創自行決定。

會出現哪些題目

Atomica 聚焦的硬體領域，與台灣電子、精密製造與無人載具供應鏈高度重疊



AI 與邊緣運算

專用晶片封裝、散熱設計、邊緣運算模組



通訊與低軌衛星

RF 元件、相位陣列天線、通訊模組整合



醫療器材

微型感測器良率、低功耗晶片、法規相容製造



機器人與智慧製造

致動器、減速機、感測融合、機構量產設計



無人載具與交通

動力系統、飛控與導航模組、電池與機構件



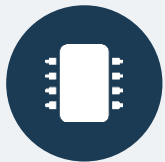
氣候科技與散熱

電源管理、熱管理材料與模組、儲能元件

以上為題型示意，非已確認題目；首批實際題目將由 Atomica 與 Liminal 盤點後公布。

這條路已經有人走通

Atomica 已完成的媒合實績，證明「美國需求 × 台灣製造」可以成交



CASE 01

矽谷半導體雷射新創

- 需求：找到可量產的晶圓代工夥伴
- 結果：與台灣 foundry 簽約



CASE 02

美國 smart glasses 公司

- 需求：設計與製造供應鏈
- 結果：連結亞洲設計、製造與供應鏈資源

Atomica 的鏈結基礎 Liminal (Temasek 成立的 Founders' Studio)、FSV、10+ 家波士頓創投；MIT CSAIL、MassRobotics、Greentown Labs、Harvard Innovation Labs 等生態系夥伴；協會已與 Atomica 合辦 VC Happy Hour。

平台要做的，是把個案經驗變成可複製的常態機制，讓更多台灣企業接得到題目。

參與企業得到什麼

不只是一張訂單，而是提早進入下一代客戶的研發週期



第一手需求

直接看到波士頓新創的規格與痛點，掌握技術走向



早期卡位

在原型階段就參與，量產時成為優先供應商



共同開發

視案件洽談共同開發與成果分享，而非只賺加工費



國際曝光

透過 Atomica 活動、Podcast 與影音，讓美國創投看見



資源加乘

協會結合法人與學研會員，協助申請 A+、產創、SBIR、CITD 補助



市場延伸

隨美國新創前進第三市場（Atomica 規劃中東）

越早參與解題，越有機會在新創量產時成為指定供應商。

誠邀哪些夥伴

協會會員與非會員的台灣企業、法人、學研單位皆可登錄

解題夥伴類型



零組件與模組廠
馬達、電池、感測器、通訊、飛控



製造與 EMS
PCBA、機構件、系統組裝、NPI



設計服務
機構、電子、韌體、DFM 顧問



法人與學研
可行性研究、實驗室驗證、測試認證

三種合作模式

模式	內容	適用
委託開發	新創付費，企業執行設計 / 打樣 / DFM	快速見效、權責單純
共同開發	雙方共同投入，成果與權益依約分配	適合關鍵技術、長期合作
量產供貨	解題成功後轉為正式供應合約	最終商業目標

登錄即進入協會「解題夥伴庫」，題目公布時依能力標籤主動通知。

11 月中旬 台美硬體新創合作論壇

讓雙方企業彼此了解能量與需求，並在現場促成 MOU 簽署

論壇資訊

時間 2026 年 11 月中旬 (日期待定)

地點 台灣 (場地待定) ；波士頓端視需要線上連線

主辦 TUVIDA × Atomica × Liminal

對象 協會會員、台灣企業與法人 ； Atomica 與 Liminal 新創、創投



了解能量

台灣企業簡報製造、設計與驗證能量，讓美國新創知道「誰能做」



掌握需求

波士頓新創發表題目：規格、時程、預算，讓台灣企業知道「要做什麼」



促成 MOU

依預媒合結果安排一對一會談，雙方有共識即現場簽署合作備忘錄

議程架構 (草案)

01

開幕與平台說明

02

新創需求發表

03

台灣企業能量簡報

04

一對一媒合會談

05

MOU 簽署儀式

06

交流茶敘

論壇不是終點：每份 MOU 附 90 天行動項，由協會追蹤轉為 NDA、提案與合約。

從論壇到 MOU：參與企業怎麼準備

論壇前完成預媒合，讓現場每一場會談都有明確目標



MOU 建議內容 (範本由協會提供)

- 合作範圍：對應的題目與預期成果
- 雙方窗口與 90 天行動項 (NDA、提案、會議)
- 保密原則：完整規格於另簽 NDA 後揭露
- 非約束性：不涉價金、智財歸屬與獨家條款

MOU 為合作意向書，不涉價金與智財移轉；實質權利義務於後續 NDA 與合約中約定。

善用政府研發資源

經濟部多項研發補助都可作為申請目標，協會結合法人與學研會員協助媒合成功的企業申請



A+ 企業創新研發淬鍊計畫

經濟部產業技術司

- 全球研發創新夥伴：適合台美跨國合作研發
- 補助上限為計畫總經費 50%；國外企業須在臺設研發部門



產業升級創新平台輔導計畫

經濟部產業發展署

- 產業技術與產品高值化開發，可個別或聯盟申請
- 適合承接規模較大、需整合多家企業的題目



SBIR 小型企業創新研發計畫

經濟部中小及新創企業署

- 中小企業創新研發（實收資本額 1 億元以下或員工 200 人以下）
- Phase 1 最高 150 萬元；Phase 2 個別最高 1,200 萬元



CITD 協助傳統產業技術開發計畫

經濟部產業發展署

- 新技術、產品、零組件或原材料開發；分產品開發與研發聯盟
- 研發聯盟有新創成員者優先納入補助



協會協助機制

協會 × 法人會員 × 學研會員

1

選計畫

依企業規模、題目性質與合作對象，選擇最合適的補助計畫

2

補能量

法人與學研會員協助可行性研究、測試驗證與產學合作

3

寫計畫

協助研擬計畫書架構、技術路徑與預算規劃

4

追執行

核定後協助查核點管理，銜接量產與後續計畫

補助類別、金額與資格以各主管機關當年度申請須知為準；協會協助評估、規劃與撰寫，核定與否由主管機關審查。

推動時程

以 11 月中旬論壇為起點，先促成首批 MOU，再擴大為常態平台

第一階段 2026 Q4

- 協會與 Atomica、Liminal 確認三方分工
- 招募解題夥伴；兩端夥伴盤點首批新創需求
- 11 月中旬論壇：交流能量與需求、簽署 MOU

第二階段 2027 Q1 – Q2

- MOU 轉為 NDA、提案與合約
- 首批題目進入打樣與驗證
- 協助申請 A+、產創、SBIR、CITD 等補助

第三階段 2027 Q3 起

- 成為常態平台，定期公布題目
- 年度論壇 + Taiwan Manufacturing Tour
- 累積案例，擴大領域與中東市場

第一階段的重點是「把 MOU 變成實際合作案」，而不是追求簽署數量。

風險、建議與下一步

協會先把規則講清楚，讓企業放心參與

風險	影響	因應方式
題目品質與付款能力	中	協會篩題；Atomica 提供新創募資階段；初期以委託開發、分期付款降低風險
智財與保密	高	分級揭露：先公開摘要，簽 NDA 後給完整規格；IP 歸屬於合約前約定
出口管制與資安	高	無人機、通訊、AI 晶片等可能涉美國出口管制與 NDAA；零件來源須非陸製
補助資格與核定	中	各計畫資格不同（如 A+ 須國外企業在臺設研發部門、SBIR 限中小企業）；協會依題目選計畫，並由法人、學研會員補強
新創失敗、訂單延宕	中	以打樣與小量產定位；不預期短期大量營收
三方分工與窗口不清	中	10/15 前簽三方合作備忘錄，明訂出題、媒合、追蹤權責
MOU 流於形式	中	論壇前預媒合；MOU 附 90 天行動項，協會追蹤轉為合約
論壇籌備時程緊	中	距 11 月中旬約 7 週；10 月中前確認日期、場地與首批新創名單



建議

- 協會：訂定需求卡、MOU、NDA 範本（秘書處 + 兩端夥伴）
- 企業：登錄能量、指定英文窗口，報名論壇
- 企業：參與前完成出口管制與零件來源自查



下一步

10/15 前	確認三方分工與論壇日期	三方
10/20 起	開放能量登錄與報名	秘書處
10/31 前	提交首批新創需求	兩端夥伴
11/7 前	完成預媒合與會談排程	協會
11 月中旬	論壇 + MOU 簽署	雙方企業
12 月底	MOU 90 天追蹤啟動	協會

結論

成為第一批解題夥伴，把「接單」升級為「共同解題」



核心判斷

美國硬體新創在原型與量產階段需要可信任的製造夥伴，台灣正具備這個能力；平台讓台灣企業在需求成形之初就參與。



關鍵依據

出題端有 Atomica (已促成半導體雷射新創與台灣 foundry 簽約) 與 Temasek 成立的 Liminal，連結 10+ 家波士頓創投與 MIT 等生態系；並可申請 A+、產創平台、SBIR、CITD 等經濟部研發補助，由協會結合法人與學研會員協助。



整體風險

中度，可管理。主要在智財保密、出口管制、新創履約能力與論壇籌備時程；協會以預媒合、MOU / NDA 範本與 90 天追蹤降低風險。



邀請與方向

請會員與台灣企業 10/20 起登錄能量並報名 11 月中旬論壇；以論壇促成首批 MOU，2027 上半年轉為打樣與實際合作案。



美國出題，台灣解題——一起把好技術做成好產品。

感謝聆聽，敬請指教

社團法人中華民國無人載具系統產業發展協會 (TUVIDA)

11 月中旬 台美硬體新創合作論壇 | 報名與登錄請洽協會秘書處 | 合作夥伴：Atomica (Boston) 、Liminal